

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 4 月 28 日 (28.04.2005)

PCT

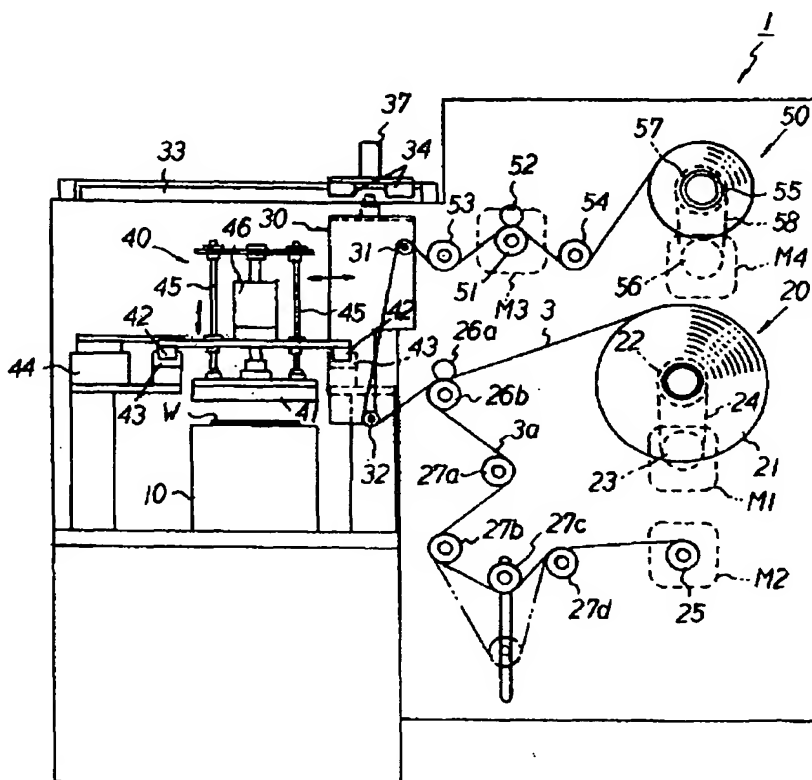
(10) 国際公開番号
WO 2005/037698 A1

- (51) 国際特許分類⁷: B65H 41/00, H01L 21/78 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/014820 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 明地 武志
(22) 国際出願日: 2004 年 10 月 7 日 (07.10.2004) (AKECHI, Takeshi) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区
(25) 国際出願の言語: 日本語 本町 2 3-2 3 Tokyo (JP).
(26) 国際公開の言語: 日本語 (74) 代理人: 山下 亮一 (YAMASHITA, Ryoichi); 〒1620052
(30) 優先権データ: 特願 2003-357168 2003 年 10 月 17 日 (17.10.2003) JP 東京都新宿区戸山 1 丁目 1 番 5 号エールプラザ戸山
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リン 台 2 0 9 号 Tokyo (JP).
テック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP];
〒1730001 東京都板橋区本町 2 3-2 3 Tokyo (JP).
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: ADHESIVE TAPE PEELING DEVICE

(54) 発明の名称: 接着テープの剥離装置



(57) Abstract: An adhesive tape peeling device capable of easily and efficiently peeling adhesive tape formed into pieces from a plate-like member. The device for peeling a surface protective tape (adhesive tape)(2a) formed into chip sizes and stuck on the surface of a wafer (plate-like member) W comprises a peeling tape supply means (20) delivering a peeling tape (3) to the wafer W set on a suction table (10), a peeling tape sticking means sticking the peeling tape (3) delivered by the peeling tape supply means (20) on the entire surface of the surface protective tape (2a) stuck on the surface of the wafer W, a heating means heating, together with the adhesive tape, the peeling tape stuck on the entire surface of the adhesive tape by the peeling tape sticking means, a tape peeling means peeling off, together with the peeling tape, the adhesive tape adhered to the peeling tape by heating by the heating means from the plate-like member, and a collecting means collecting the adhesive tape peeled off from the plate-like member by the tape peeling means and the peeling tape.

[続葉有]



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(57) 要約: 個片化された接着テープを板状部材から容易に且つ効率良く剥離することができる接着テープの剥離装置を提供する。チップサイズに個片化されてウエハ（板状部材）Wの表面に貼付された表面保護テープ（接着テープ）2aをウエハWから剥離する装置を、吸着テーブル10上にセットされたウエハWに対して剥離テープ3を繰り出す剥離テープ供給手段20と、該剥離テープ供給手段20によって繰り出された剥離テープ3をウエハWの表面に貼付された表面保護テープ2aの全面に貼付する剥離テープ貼付手段と、該剥離テープ貼付手段によって接着テープの全面に貼付された剥離テープを接着テープと共に加熱する加熱手段と、該加熱手段による加熱によって剥離テープに付着した接着テープを剥離テープと共に板状部材から剥離するテープ剥離手段と、該テープ剥離手段によって板状部材から剥離された接着テープと剥離テープを回収する回収手段と、を含んで構成する。